

应用指南

锡膏转移率与转移效果对印刷工艺的影响？

锡膏转移效率：模板开孔释放的总锡膏量百分比%
是可测量并量化的参数指标

锡膏转移效果：锡膏印刷图形形状和体积变化
影响成品率和可靠性的定性特性参数



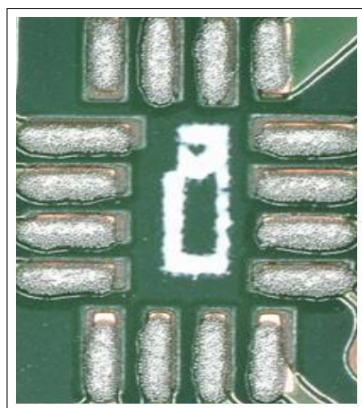
锡膏印刷量不是越多越好！

µBGA器件或0201元件I/O焊盘锡膏量通常是400 mils³，如果增加25%，锡膏总量达到500 mils³，就会引起桥接、锡珠、立碑、或过度倾斜。所有这些缺陷都需要返工处理。

微型化元器件贴装中，过多锡膏是造成良率降低的一个原因。

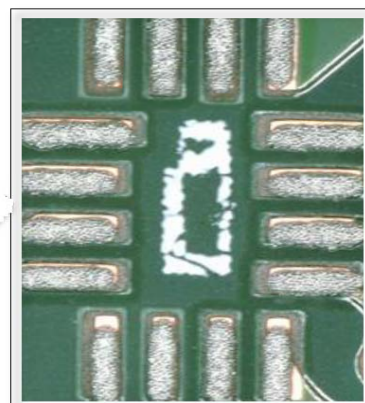
0.4mm QFN器件产线实例(100µm模板开孔)

模板未使用纳米涂层



- 锡膏量过多
- 体积变化大
- 印刷形状质量差
- 锡膏产生缺陷危险增大

使用 **nanoclear**



- 合适的锡膏量
- 体积变化不明显
- 印刷形状质量好
- 锡膏产生的缺陷危险降低

另请参考：[NanoClear®纳米涂层如何提高模板印刷质量？](#)
或 [如何使用工艺统计进行锡膏印刷质量控制？](#)